オンライン聴講 可

https://www.nagano-jisso.com/

第38回長野実装フォーラム　*共催 次世代パワーエレクトロニクス研究会*

TGV ガラスコア、インターポーザの最新先端技術を知る

今から本格的に始めないと 2030 年、世界に勝てない

半導体の微細化が限界に近づく中、AI・HPC（高性能コンピューティング）などの高性能化を支える次世代半導体実装技術として、ガラスコア基板や TGV（ガラス貫通電極）を用いたインターポーザが世界的に注目されています。ガラスの優れた寸法安定性や平坦性などを活かした技術開発が進む一方、微細 TGV 形成や高密度配線、信頼性の確保など、実用化に向けた課題も残されています。

また、ガラス基板は高周波受動素子やセンサーなどにも応用されており、磁性薄膜を利用したインダクタの形成など、磁気エレクトロニクス分野との技術的な接点も広がっています。こうした異分野の技術融合は、次世代半導体パッケージのさらなる高機能化につながるものと期待されます。

長野実装フォーラムでは、故傳田精一代表理事が 2010 年頃からガラス実装技術の先駆的な調査・研究に取り組み、2014 年には公開研究会を開催するなど、10 年以上にわたりその動向に注目してきました。現在、ガラスコア技術は半導体産業の将来を左右する重要な技術の一つとして、2030 年を見据えた開発が本格化しています。

今回は、FICT 株式会社、奥野製薬工業株式会社、新光電気工業株式会社および当フォーラム理事を講師に迎え、TGV ガラスコア基板・インターポーザの最新技術と開発動向をご紹介いただきます。さらに、講演後のオープンディスカッションでは、実用化への課題や 2030 年に向けて今から取り組むべき対応策について、参加者の皆様と幅広く議論したいと考えています。

本フォーラムでは、材料・デバイス・実装技術の幅広い視点から、次世代半導体実装技術の現状と将来展望を共有し、今後の技術開発や事業展開を考える機会としたいと思います。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

主　催　　長野実装フォーラム
　　公益財団法人 長野県産業振興機構

【 日　時 】　２０２６年１２月 ８日（火）１３：００～１６：５０

【 会　場 】　ホテル信濃路 ２階 穂高　https://www.hotel-shinanoji.com/access/
（長野市中御所岡田町 131－4　TEL：026-226-5212）

【プログラム】

13：00	開会挨拶　　長野実装フォーラム（NJF）代表　　若林 信一
13：10	1. 多層ガラス集積技術による 3D ガラスチップレットパッケージの実現に向けて FICT(株）研究開発センター センター長　飯田 憲司 氏
13：45	2. ガラス関連実装技術の進展と実現のための要素技術と課題 ～ NJF が 10 年以上追い続けているガラス実装技術 ～ Grand Joint Technology Ltd.　大西 哲也 氏
14：30	休　憩
14：45	3. ガラスコア基板への密着シード形成および高アスペクトスルーホールフィリングの挑戦 奥野製薬工業(株）総合技術研究所　基板半導体領域　吉川 純二 氏
15：20	4. AI/HPC 向け大型パッケージを実現するガラスコア基板開発動向 新光電気工業(株）　開発統括部 プロセス開発部 部長　松木 隆一 氏
16：10	オープンディスカッション　＊詳細下記
16：50	閉　会
17：10	交 流 会　（場所：1F レストラン・らぽむ）

＊オープンディスカッションでは、ご講演者に加え、特別ゲストをお迎えし、「2030 年、ガラスコア基板はどこまで実用化されるのか。そして、日本の企業は今から何に取り組むべきなのか。」ガラスコア基板の技術的な実現性、量産化に向けた課題、そして今後の技術開発や事業化の方向性について、材料・製造技術・パッケージ開発など、それぞれの立場から議論を深めます。

＜特別ゲスト＞

- 新光電気工業株式会社 執行役員　荒木 康 氏
- 日本 AMD 株式会社 Director　　斉木 一 氏

【 募集人数 】　会場参加：８０名，　オンライン参加：５０名

【 参 加 費 】　フォーラム　：１０，０００円　（テキスト代を含む）
交 流 会 費　：　６，０００円　（交流会申込みは期限厳守でお願いします）

※ 参加費は，当日支払(現金) または 指定口座にお振込み

※ Zoom でのオンライン聴講もできます。参加費を事前にお振込み頂ければ招待状をお送りします。
事前お振込が難しい場合は、その旨を申込書の「その他ご希望事項等」欄にご記入ください。
オンライン聴講の場合は、後日テキストを申込書のご住所宛てに郵送させていただきます。
また、オンライン聴講の方は当日の質疑応答は行えません。アンケートで質問をお受けして、後日講演者からまとめてご回答いただきます。

【 申込方法 】　１２月 １日（火）までに
電子メール mchino@chino-tec.com で、以下の項目にご記入の上、お申し込み下さい。
① 氏名（フリガナ）：
② メールアドレス：
③ 勤務先・ご所属（役職）：
④ 郵便番号・ご住所：
⑤ フォーラム参加区分：会場参加(10,000 円)または Zoom 参加(10,000 円)
⑥ 交流会参加：申込む(6,000 円)または申込まない
⑦ その他ご希望事項等
支払いをお振込み希望の方には折返し振込先をご連絡させていただきます。
※ 事務局からの連絡は原則メールで行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。

【お問合せ先】　長野実装フォーラム庶務理事　手塚 佳夫
E-mail：　tezuka@chic.ocn.ne.jp　　TEL：　090-4230-9187